

公司代码：688049

公司简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要



第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

充分考虑到公司的整体盈利水平以及目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积金不转增股本，不送红股。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	炬芯科技	688049	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	XIE MEI QIN
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
电话	0756-3673718
电子信箱	investor.relations@actions-semi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务情况

公司是低功耗系统级芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。

2. 主要产品情况

公司的主要产品为蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等，广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、智能手表、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等领域。

公司的 SoC 芯片系列产品作为系统级芯片，将多个模块或组件、算法及软件等集成到一颗芯片中，对于基于先进半导体工艺的芯片研发设计及软硬件协同开发技术的要求较高。公司的 SoC 芯片包含完整的硬件电路及其承载的相关嵌入式软件和算法，在进行芯片设计的同时提供了相应的应用方案；将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能，应用领域广泛。

公司的核心产品：



(1) 蓝牙音频 SoC 芯片系列：公司的蓝牙音频 SoC 芯片主要应用于蓝牙音箱（含 TWS 音箱、智能蓝牙音箱）、蓝牙耳机（含 TWS 耳机、智能耳机）、智能手表等。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATS281X 系列、ATS282X 系列、ATS283X 系列(除 ATS2837)、ATS285X 系列	普通蓝牙音箱（含 TWS 音箱）、智能蓝牙音箱、soundbar、蓝牙车载产品、K 歌麦克风、无线麦克风、蓝牙收发一体器	华为、哈曼、SONY、OPPO、罗技、安克创新、沃尔玛、小米、天猫精灵、漫步者、不见不散、唱吧、现代、绿联、Vizio、RODE 等
	ATS301X 系列	TWS 耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机等蓝牙可穿戴设备	传音、摩托罗拉、网易云音乐、realme、JBL、倍思、百度、TOZO、Nosie、黑鲨

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

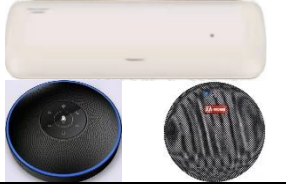


(2) 便携式音视频 SoC 芯片系列：便携式音视频 SoC 芯片系列是公司最早耕耘的、最成熟的产品线，全球市场占有率长期较高，搭载了公司长期积累的、较先进的低功耗音视频处理技术。该系列芯片主要针对便携式高品质音视频编解码类产品的应用。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
------	--------	--------	--------

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATJ212X 系列、 ATJ215X 系列、 ATJ2167	高品质音乐播放器、 录音笔	纽曼、飞利浦等
	ATJ229X 系列、 V100	高品质视频播放器、 广告机、数码相框、 视频故事机	夏新、先科、创维等

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(3) 智能语音交互 SoC 芯片系列：公司的智能语音交互 SoC 芯片为满足该市场的碎片化需求，提供了多种架构的系列产品；通过低功耗、高性价比来满足新兴的智能教育、智能办公、智能家居等领域的智能升级需求。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATS360X 系列	智能办公类产品（如会议音箱）、智能家居和家电话音交互模组	eMeet、音络等
	ATS2837	智能录音笔、无线麦克风等	科大讯飞、飞利浦、汉王等
	ATB110X 系列	蓝牙语音遥控器、语音鼠标、语音键盘、翻译棒及其它数据传输类产品	罗技、BBTV、创维，长虹，夏普等

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(二) 主要经营模式

作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的 Fabless 经营模式，即专门从事集成电路的研发设计，晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成，取得芯片成品后对外销售。同时，为了缩短芯片产品的面市时间，降低客户的开发门槛，公司在提供 SoC 芯片的同时，提供完善的 SoC 软件开发平台（算法库、OS、SDK、应用软件和开发工具等），针对不同品类的特性以及市场需求，为客户提供融合硬件和算法的整体解决方案。

1、研发模式

公司研发流程如下：

在立项阶段，市场部根据市场调研情况提出市场需求，各研发部门根据市场需求文档提出各自领域的研发需求以及技术创新需求，由项目经理组织各部门进行需求的可行性评估和立项评审。当项目评审通过后，项目正式立项。

在研发阶段，各研发部门共同讨论并制定芯片的设计规格书，IC 研发部将根据设计规格书进行电路设计、仿真和验证、物理实现以及封装设计工作，完成所有工作后，召开 Tapeout 评审会议；同时，系统研发部和算法研发部进行芯片应用方案的开发工作。在新产品 Tapeout 评审会通过后，制造工程部委托晶圆制造厂、封装测试厂依照与量产流程相似的标准进行样品试生产，同时进行晶圆和封装测试环境的开发。样品完成后，各研发部门会进行芯片验证和样机测试，核实样品是否达到各项设计指标。

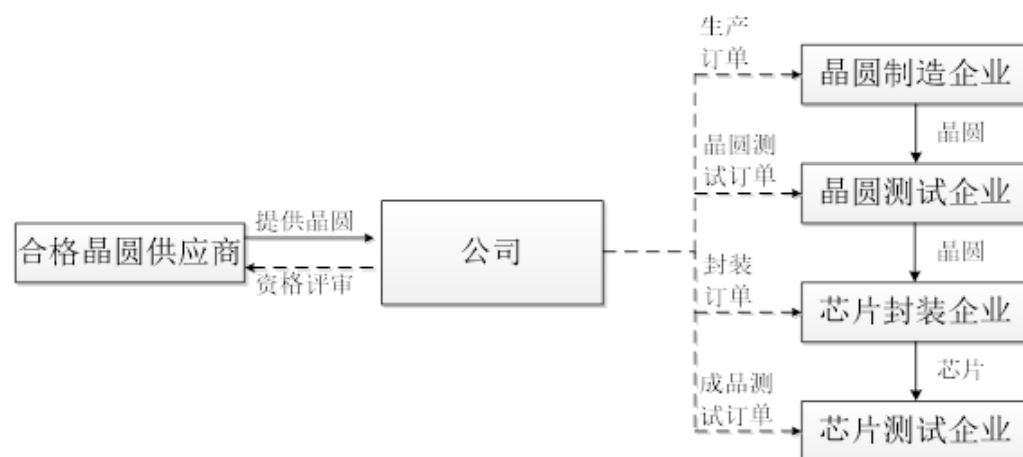
在新产品验证通过后，系统研发部将发布应用方案级别的软件和硬件开发平台，开始进行客户端产品试量产。在试量产成功完成后，进入芯片量产阶段。

2、采购与生产模式

公司采用 Fabless 模式，主要负责集成电路的设计，因此需要向晶圆制造厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

运营管理部依据市场部/业务部的出货预测制定相应采购计划和生产计划，并由晶圆制造厂和封装测试厂完成晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试等委外生产工作。此外，公司还会采购存储等配套芯片。

采购生产流程:



3、销售模式

根据集成电路行业惯例和自身特点，公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，均为买断式销售。公司在销售过程中，除了提供 SoC 芯片，还可为客户提供融合硬件和算法的整体解决方案。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

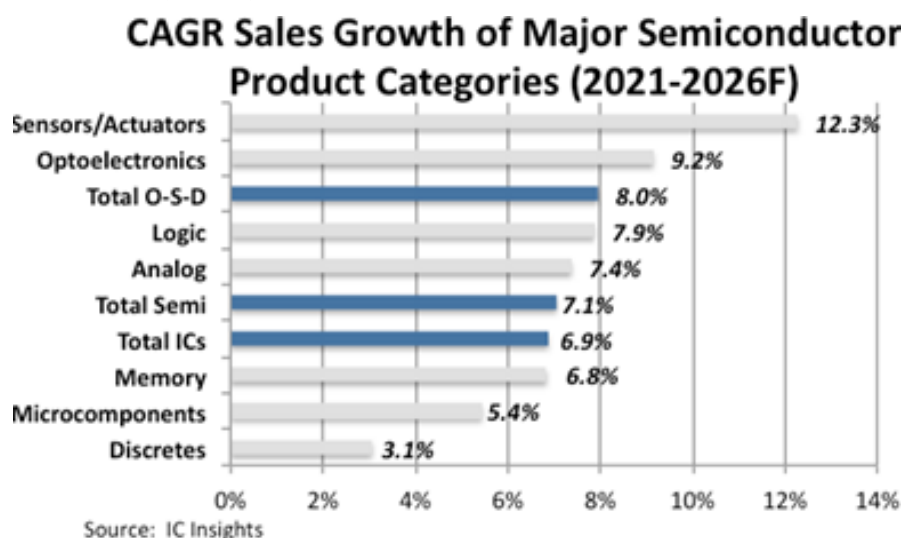
公司主营业务为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。

(1) 行业的发展阶段及基本特点

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期，行业处于快速发展阶段，正全力追赶世界先进水平。国家十四五规划也再次将集成电路产业列为国家重点发展的产业。2021 年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021

年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4,519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3,176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2,763亿元，同比增长10.1%。

根据IC Insights的统计分析和预测，全球IC设计产业规模多年实现增长态势。从2016年到2021年，整个半导体市场的复合年增长率（CAGR）为11.0%，未来五年半导体总销售额将以7.1%的更温和的复合年增长率增长。



①近年来蓝牙的技术革新带动蓝牙音频 SoC 芯片需求快速增长

近年来随着物联网行业蓬勃发展，蓝牙作为物联网无线连接的主要方式之一，终端设备应用场景诸多，出货量自1998年蓝牙技术推出以来即呈现持续增长的趋势，尚无放缓迹象。根据SIG的预测，至2026年蓝牙设备年出货量将超过70亿台，2022年到2026年的年复合增长率将达到9%。其中，音频传输是蓝牙技术最早和最重要的应用领域，从蓝牙技术推出以来便呈现技术不断革新与终端应用持续增长态势。由于音频传输是蓝牙物联网设备及可穿戴技术最为成熟、应用场景最为完备的领域，蓝牙音频设备在近些年也成为智慧互联的首要流量入口。根据SIG的统计及预测，2021年全球蓝牙音频产品的出货量近13亿台，到2026年仅蓝牙音频传输设备年出货量将超过18亿台，2022年到2026年的年复合增长率将达到7%。随着蓝牙5.2标准特别是LE Audio的发布和广泛使用，蓝牙技术将在辅听设备、腕穿戴等健康运动类穿戴设备上大放异彩，并形成下一个风口行业。

②便携式音视频 SoC 芯片行业呈现“长尾效应”，市场已向公司为代表的头部企业集中

便携式音频 SoC 芯片主要应用于便携式音频播放器和便携式录音笔等，便携式视频产品广泛用于唱戏机和广告机等领域，已进入“长尾状态”。便携式音视频产品在公司整体产品体系布局中，承担着稳定的业绩贡献和技术发展基础。

③智能语音交互 SoC 芯片仍处于市场爆发前期，具有广阔的市场前景

随着信息技术的发展，智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。未来智能语音交互能够创造全新的“伴随式”场景。语音交互相比其他图像、双手操控，语音入口确实有种种超越优势，空间越复杂，越能发挥优势。

而当前云计算、5G、深度学习、AI 芯片等技术相继成熟，人们探讨的不再仅仅局限于围绕智能家居为中心的生活场景，“AI+IoT”概念的提出，还产生出智能城市、智能制造、智能办公、智能座舱、智能教育等更多的领域，产生出更大的市场空间和价值。

(2) 主要技术门槛

集成电路设计的流程首先要进行软硬件划分，将设计基本分为两部分：芯片硬件设计和软件协同设计。高质量的芯片不仅需要在体积、容量、安全性方面满足市场要求，还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等诸多需求，因而集成电路设计公司既需要掌握各种元器件的应用特性，又需要以技术积累和行业经验为基础熟悉配套的软件技术。此外，芯片产品的研发设计需要紧密跟上国际先进技术水平，同时优化现有技术，持续进行改进和创新，提高产品应用设计能力，才能在行业众多竞争者中占据优势。公司的 SoC 芯片包含完整的硬件电路及其承载的相关嵌入式软件和算法，产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入公司所在行业具有很高的技术壁垒，行业内的后来者短期内很难突破核心技术壁垒，只有经过长时间技术探索和不断积累才能与拥有技术优势的企业相竞争。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是较早从事 SoC 芯片研发、设计和销售的高新技术企业，经过多年在智能音频芯片领域的研发投入、技术积累和发展，公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰，技术水平较先进，成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司的核心技术涵盖了高性能音频 ADC/DAC 技术、高性能蓝牙通信技术、高集成度的低功耗技术、高音质体验的音频算法处理技术、高度自主 IP 技术以及高集成度 SoC 设计整合框架、高性能软硬件平台的系统融合技术等。公司产品在专业音频厂商中占有率较高，并已进入多家知名的手机品牌和互联网厂商的耳机、音箱等不同形态的智能终端产品供应链中。从覆盖品牌的广度和深度上看，公司具有明显优势。

（1）蓝牙音频 SoC 芯片系列

①蓝牙音箱 SoC 芯片系列

公司是全球蓝牙音箱 SoC 芯片的重要供应商之一。得益于公司产品竞争力的不断提升和国产替代大趋势下的市场机遇，蓝牙音箱芯片已是公司目前的主力产品和重要收入来源。在蓝牙音箱领域，公司已成为行业终端品牌的主流供应商并可实现中高端蓝牙音箱 SoC 的国产替代。公司主要服务于国内外一二线终端品牌，包括安克创新、华为、小米、哈曼、SONY、罗技等众多终端品牌，通过提供差异化搭配的系列芯片组合，可满足市场上终端品牌的差异化需求，得到了业界主流终端品牌和 ODM/OEM 代工厂的普遍认可。

在便携式蓝牙音箱市场趋于稳定的同时，soundbar 市场正在稳健的增长中，根据 technavio 研究报告显示，soundbar 市场 2020 年至 2024 年的年复合增长率达 15%，2021 年炬芯在 soundbar 市场进入了 SONY、Vizio 等知名品牌客户供应链。同时公司也积极布局差异化细分市场，公司产品于 2021 年进入无线麦克风领导品牌 RODE 的供应链。

2021 年度，凭借较强的技术实力，公司的蓝牙音箱 SoC 芯片系列以较高的增长率持续渗透国内外终端品牌。

②蓝牙耳机 SoC 芯片系列

TWS 蓝牙耳机 SoC 芯片是公司布局蓝牙穿戴市场的第一个落地点。Counterpoint Research 最新显示报告，2021 年全球 TWS 耳机的出货量达到 2.996 亿台，接近 3 亿台，出货量同比增长 24%。

公司 2021 年针对 TWS 蓝牙耳机市场推出了支持单双麦 ENC 的 ATS301X 系列的升级芯片以及支持 ANC 和 LE Audio 的 ATS302X 系列芯片，在音质、功耗、通话降噪、低延时、传输稳定性等方面都有了全新的升级，是目前市场上针对手机品牌、专业音频品牌及电商品牌等客户主流产品极具竞争力的解决方案。其拥有最新的蓝牙 5.3 双模配置，在实现低功耗的基础上，有效地提升了音频连接的稳定性，同时支持低延时模式，蓝牙音频信号延时低至 50ms。针对通话体验已全部升级为 AI 通话降噪算法，音频底噪性能达到了业界较高水平 2 微伏级别。

公司 TWS 蓝牙耳机 SoC 芯片 2021 年进入 realme、JBL、倍思、百度、TOZO、Nosie、黑鲨等终端耳机品牌供应链。同时公司积极布局差异化市场，如蓝牙话务耳机、无线电竞耳机和蓝牙辅听耳机等。报告期内，公司 TWS 蓝牙耳机收入持续快速增长。

③智能手表 SoC 芯片系列

智能手表 SoC 芯片是公司目前重点布局方向，也是蓝牙穿戴市场的下一个落地点。根据市场调研机构 Counterpoint Research 数据报告显示，2021 年智能手表出货量为 1.275 亿只，同比增长 24%。公司凭借多年来在低功耗技术、蓝牙双模技术、音频技术以及显示技术的积累，2021 年 12 月向市场提供的第一代高集成度的智能手表芯片 ATS308X 系列。单芯片解决方案一经推出即得到终端品牌认可，目前基于 ATS308X 的多个品牌客户智能手表机型处于试产阶段，品牌客户终端机型预计 2022 年第二季度推出市场。

(2) 便携式音视频 SoC 芯片系列

公司的便携式音视频 SoC 芯片系列产品的全球市场占有率较高，公司凭借对音质的不懈追求，在该领域积累了大量较为稳定的客户。

(3) 智能语音交互 SoC 芯片系列

公司努力开拓智能语音交互的产品应用，目前主要落地在智能办公和智能家居方面。语音交互产品已成熟量产运用于智能空调、智能家居面板、会议系统以及智能录音笔等产品中。公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等终端品牌。2021 年度，会议系统芯片及方案已成功落地，并在音络、eMeet 等国内品牌皆有产品量产上市；截止至 2021 年末，公司用于语音遥控器的智能语音交互 SoC 芯片总销量累计超千万颗。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 蓝牙音频 SoC 芯片行业技术水平及发展趋势

①蓝牙技术实现功耗、成本、功能的较好结合，在应用开发等方面拥有优势

在目前主要的几种无线通信技术中，由于蓝牙技术可实现功耗、成本、功能等方面的兼顾统一，应用开发扩展性强，在效率和安全性上均具有较大的优势。

②低功耗音频（LE Audio）技术再次改变人们体验音频方式

2020 年和 2021 年 SIG 发布了最新的基于 LE Audio 技术的蓝牙 5.2 和 5.3 的协议，LE Audio 具备低功耗、高音质等优势，同时还支持多重串流音频和广播音频等多连接的技术优势。这些 LE Audio 的技术优势不仅提升蓝牙音频性能，还可为助听器等新的应用提供更强大的支持，并支持音频分享。这一新的蓝牙技术将再次改变人们体验音频的方式，并让人们以前所未有的方式进行万物互联。

③双模蓝牙产业会全面升级支持 LE Audio 新标准，并以双模蓝牙音频形式成为市场和技术的

主流。
LE Audio 标准颁布以前，虽然双模蓝牙已经是产业主流，但音频传输仅能通过经典蓝牙模式实现，而低功耗蓝牙模式主要实现数传和控制功能。LE Audio 新标准使得低功耗蓝牙模式也能传输音频并且具备低功耗和低延时等性能优势。

双模蓝牙产业将全面升级支持 LE Audio 新标准，实现同时支持经典蓝牙以传统模式传输音频和低功耗蓝牙以 LE Audio 模式传输音频的双模蓝牙音频功能。支持双模蓝牙音频的设备既能兼容现有不支持 LE Audio 标准的蓝牙设备，又能兼容未来的仅支持 LE Audio 标准的蓝牙设备。

虽然 LE Audio 标准较经典蓝牙标准具有性能和功耗优势，也是蓝牙技术的未来发展方向，但目前主流的手机、笔记本、平板等终端设备均尚未完全支持该标准，不支持经典蓝牙标准仅支持 LE Audio 蓝牙音频的方案无法与现有存量设备兼容使用。Techno Systems Research 预计，支持 LE Audio 的安卓系统将在 2022 年更新，因此仅支持 LE Audio 单模芯片的主要市场应用要到 2025 年才逐步开始使用。预计 2025 年，双模蓝牙芯片在蓝牙耳机、蓝牙音箱及助听器中的应用仍合计占

比约 92%。

因此，在上述设备升级换代至支持 LE Audio 前，在较长的过渡期内，蓝牙音频 SoC 芯片需要同时支持经典蓝牙音频及 LE Audio 两种模式，双模蓝牙音频芯片将在较长时间内持续存在，并具有市场和技术优势；终端品牌及芯片厂商仍将以双模蓝牙音频为主要发展方向，拥有支持双模蓝牙音频技术的芯片厂商将具有较强的竞争优势。

公司的蓝牙音频芯片已经在全面升级支持 LE Audio 新标准，并支持双模蓝牙音频，可以和即将发布的支持 LE Audio 的智能手机等设备很好的兼容，并因此在低延时、低功耗、多连接等方面展示出其技术优势。

(2) 便携式音视频 SoC 芯片行业技术水平及未来发展趋势

便携式音视频 SoC 芯片在低功耗的基础上，提供高品质的多媒体信号的模拟前处理、模数转换、数字多媒体信号编解码和处理、全格式音频解码，保证数模转换和模拟后处理的全信号链每一个环节的高信噪比，满足人类感官的主观体验。未来便携式音视频 SoC 芯片将继续向低功耗、高音质和更强交互体验等方向演进，同时，也会在更丰富的细分行业应用和差异化产品品类中挖掘出新兴的应用场景。

(3) 智能语音交互 SoC 芯片行业技术水平及发展趋势

语音技术的应用一直以来都是一个不断突破并“解锁”新场景的过程。而作为智能硬件主芯片平台来说，如何以更高的集成度、更强的算力和更合适的资源配置等为重心，最大程度地设计和开发出针对语音场景的专业芯片，就成了需要不断挑战和创新的目标。同时智能语音芯片平台需要配合算法针对语音场景中关键的麦克风阵列拾音、远场语音增强、功耗水平以及用户体验等方面，提供丰富的接口、便利的算法适配以及完善的软硬件开发环境和工具，也成为重要的研究方向之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,819,259,753.85	492,622,159.22	269.30	355,682,641.42
归属于上市公司股东的净资产	1,712,037,241.73	417,172,177.57	310.39	282,117,027.27
营业收入	526,267,171.76	410,416,659.99	28.23	361,207,487.72
归属于上市公司股东的净利润	83,947,793.89	24,088,385.69	248.50	54,559,895.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,955,733.19	-915,217.18	不适用	-8,268,526.59
经营活动产生的现金流量净额	86,190,899.91	17,538,395.06	391.44	82,255,905.15
加权平均净资产收益率(%)	14.81	6.73	增加8.08个百分点	20.87
基本每股收益(元/股)	0.89	0.26	242.31	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.26	242.31	0.12
研发投入占营业收入的比例(%)	24.95	28.48	减少3.53个百分点	30.73

报告期内，公司实现营业收入 52,626.72 万元，较同期增长 28.23%；实现归属于上市公司母公司的净利润 8,394.78 万元，较上年同期增长 248.50%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,995.57 万元，较上年同期增加 6,087.10 万元。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,865.25 万元，增长 391.44%。

2021 年，公司营业收入较去年同期增长 28.23%，主要系公司产品所处市场快速发展并且产品具有竞争优势，蓝牙音箱 SoC 芯片系列和蓝牙耳机 SoC 芯片系列销售收入较上年同期增加，同时，因部分产品更新迭代和上调单价，产品平均售价提升。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 248.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈，基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 242.31%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期转正值，主要原因是公司抢抓市场快速发展机遇，产品竞争力提升，实现公司经营业绩整体大幅增长。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 391.44%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产同比增长 269.30%；归属于上市公司股东的净资产同比增长 310.39%，主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金和公司经营利润大幅增长所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,163.76	14,499.85	15,810.25	12,152.86
归属于上市公司股东的净利润	573.29	2,958.10	2,870.64	1,992.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	189.83	2,814.07	2,760.90	230.77
经营活动产生的现金流量净额	213.90	5,524.79	464.45	2,415.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2021 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润与 2021 年 7 月 7 日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）中的相应内容存在差异，差异金额为 422.39 万元，系根据财政部于 2021 年 5 月 18 日发布的《股份支付准则应用案例以首次公开募股成功为可行权条件》的相关规定，公司将 2018 年-2021 年 1-6 月（申报期）的股权激励费用的确认方式进行了更正，由在授予日一次性确认更正为在估计的等待期内进行分期摊销。在 2021 年 10 月 19 日披露的上市招股说明书（注册稿）中，公司采用追溯重述法对申报财务报表中涉及上述会计差错的相关数据进行更正。

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,062

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）						不适用		
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）						不适用		
前十名股东持股情况								
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）		28,223,600	23.13	28,223,600	28,223,600	无	0	其他
珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）		4,629,400	3.79	4,629,400	46,294,000	无	0	其他
珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业（有限合伙）		4,552,000	3.73	4,552,000	4,552,000	无	0	其他
珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）		4,118,180	3.38	4,118,180	4,118,180	无	0	其他
珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）		4,054,480	3.32	4,054,480	4,054,480	无	0	其他
珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）		4,021,930	3.30	4,021,930	4,021,930	无	0	其他
珠海威元投资合伙企业（有限合伙）		3,723,000	3.05	3,723,000	3,723,000	无	0	其他
合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）		3,696,000	3.03	3,696,000	3,696,000	无	0	其他
珠海景昇投资合伙企业（有限合伙）		3,566,000	2.92	3,566,000	3,566,000	无	0	其他
珠海铭协投资合伙企业（有限合伙）		3,538,000	2.90	3,538,000	35,380,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				未知以上股东是否存在关联关系或者一致行动关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

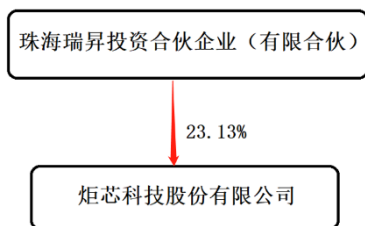
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

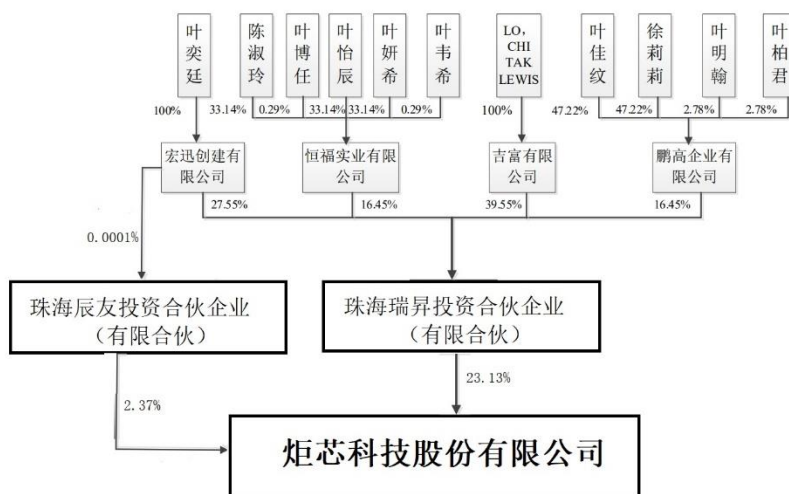
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本章“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用